

# 2013年3月期 第1四半期決算説明資料

平田機工株式会社 2012.8.10

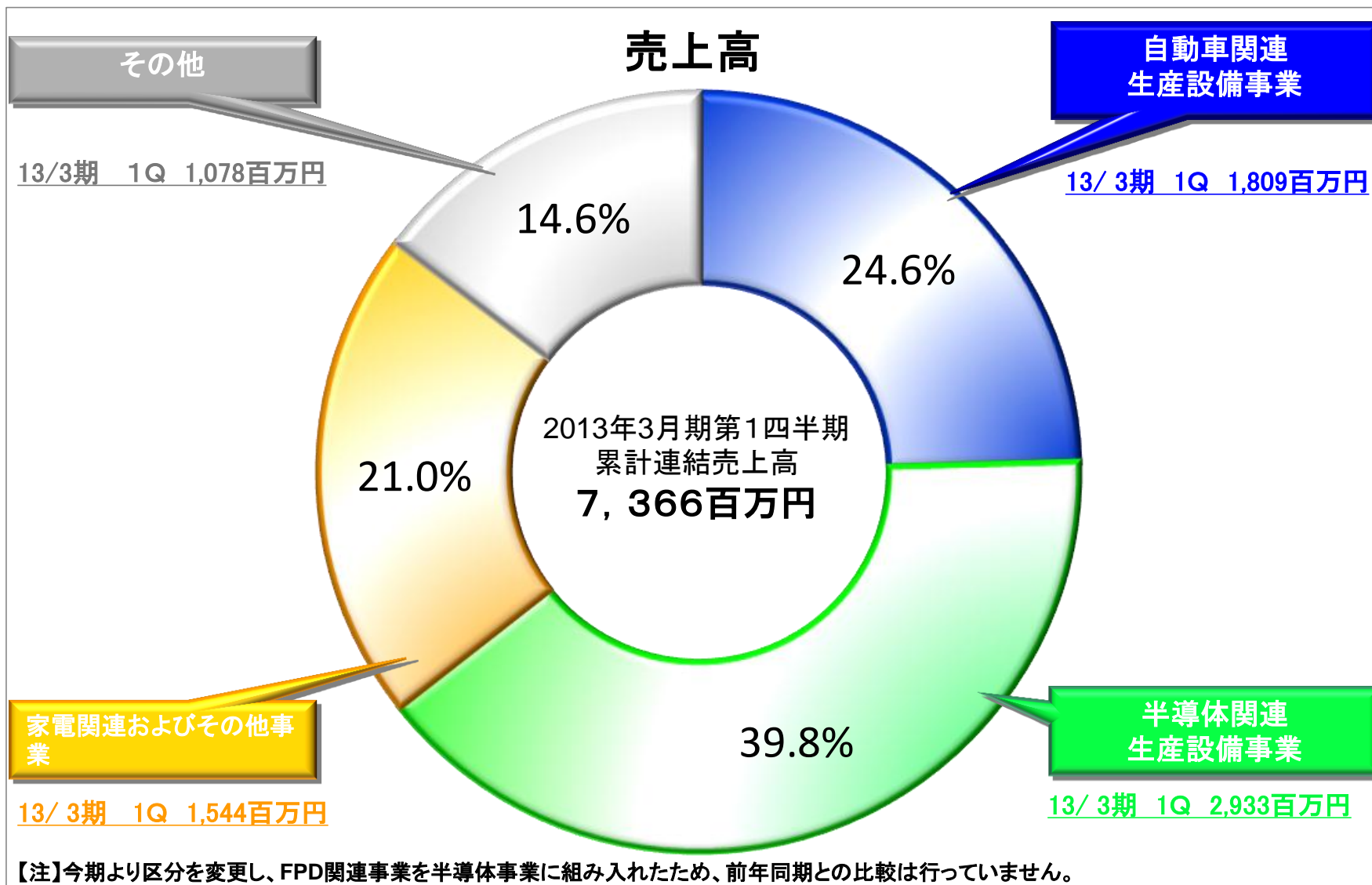


# I 決算状況

---

2013年3月期第1四半期（2012年6月30日）

# I 決算状況 事業部門別売上高構成比



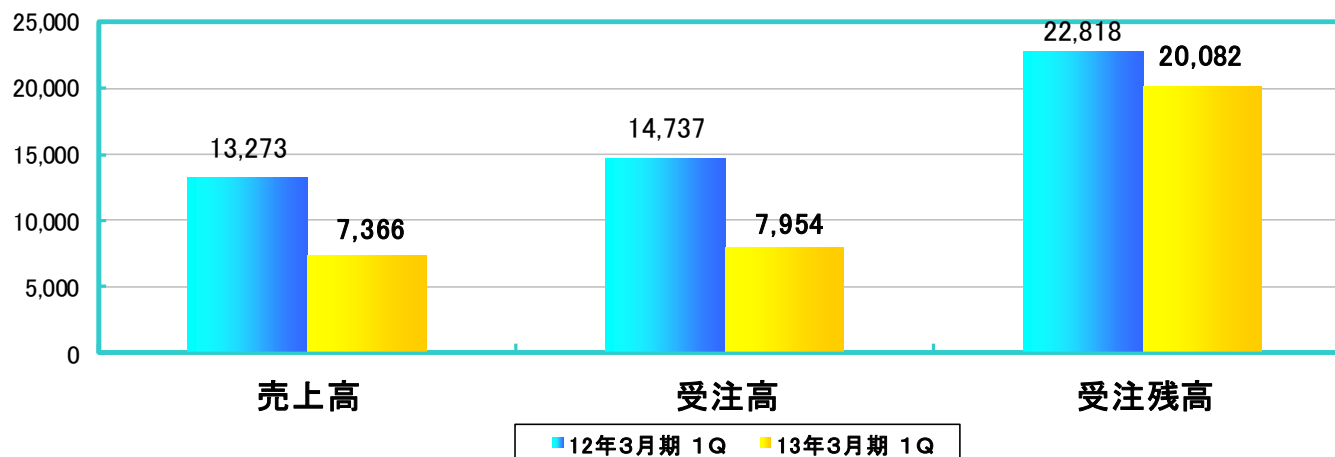
## 決算概要

- 売上予定案件の期ずれによる売上減により、連結売上高は前年同期比44.5%減となった。
- 売上減に加え、売上原価率の増加等により、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに赤字計上。
- 受注高も減少しているが、受注残高は一定の水準を維持している。

## 連結決算

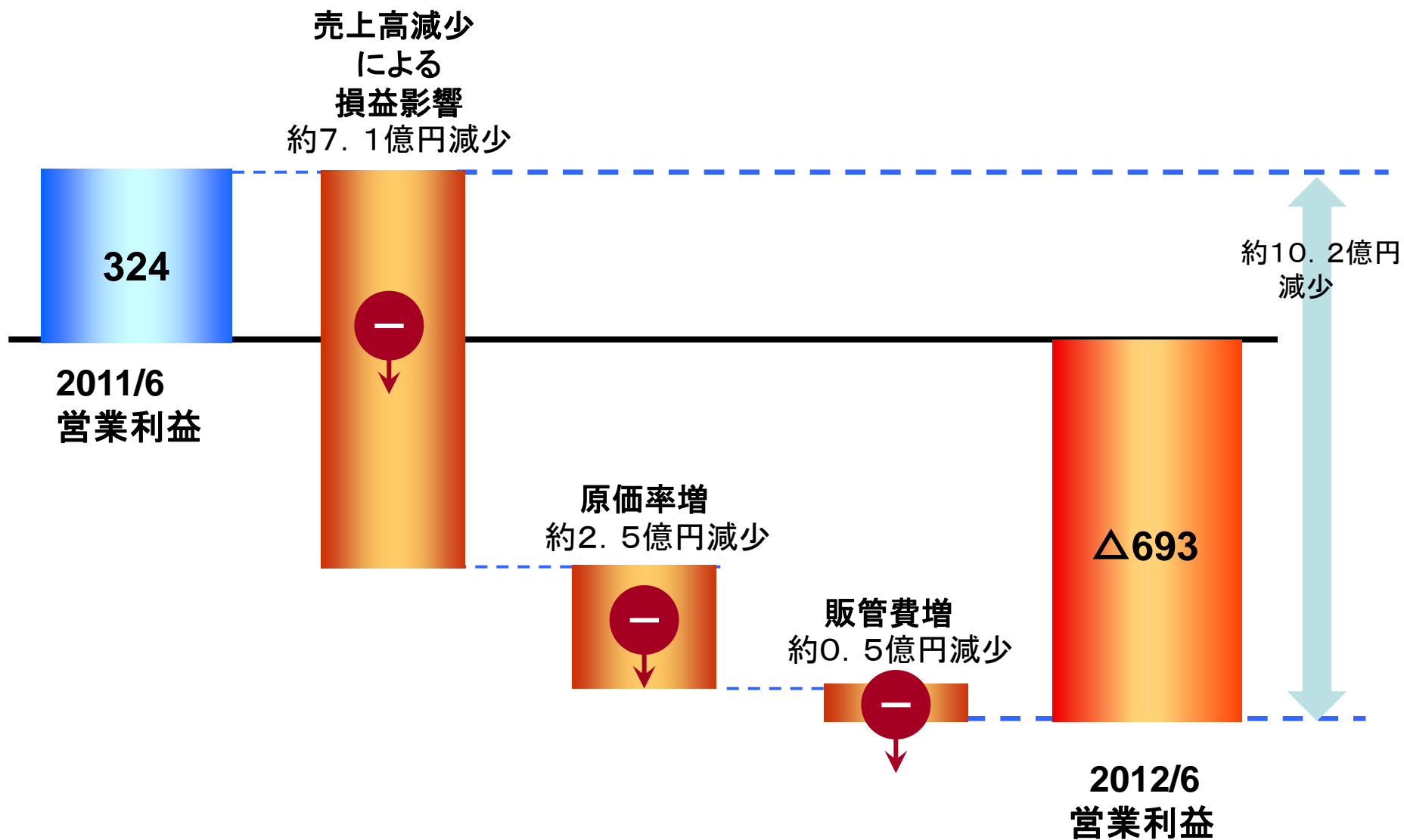
(単位:百万円)

連結決算	2012年3月期 第1四半期 実績	2013年3月期 第1四半期 実績	増減率
売上高	13,273	7,366	△44.5%
営業利益	324	△693	—
経常利益	372	△695	—
四半期純利益	187	△459	—



# I 決算状況 営業利益の増減要因分析

(単位:百万円)



# I 決算状況 事業部門別連結売上高

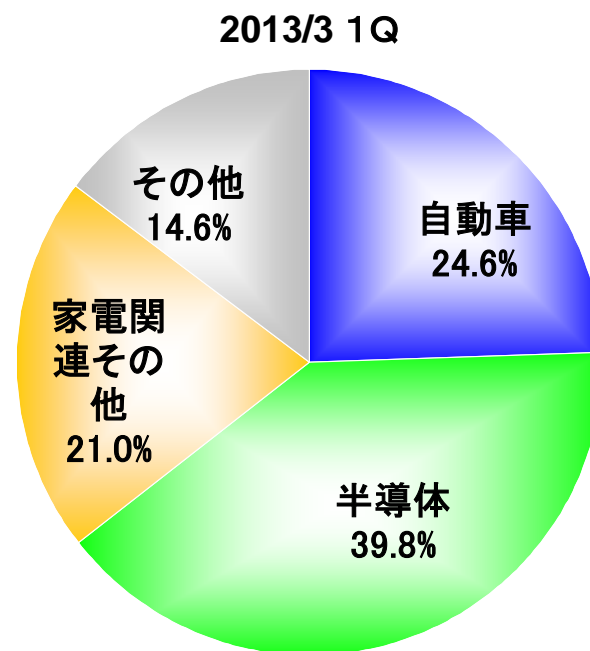
## ■ 売上予定案件が翌四半期以降にずれ込んだことから、各事業部門ともに低調。

- ・ 自動車関連設備：北米メーカーを中心に一定の売上を継続しているが、一部案件の期ずれにより低調。
- ・ 半導体関連設備：製造受託案件他、国内向け案件を売り上げたが、一部案件の期ずれにより低調。
- ・ 家電関連およびその他：家電、タイヤ等、全体的に低調。

## 事業部門別売上高の状況

単位：百万円

事業部門	2013/3 1Q
自動車	1,809
半導体	2,933
家電関連その他	1,544
その他	1,078
合計	7,366



【注】今期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

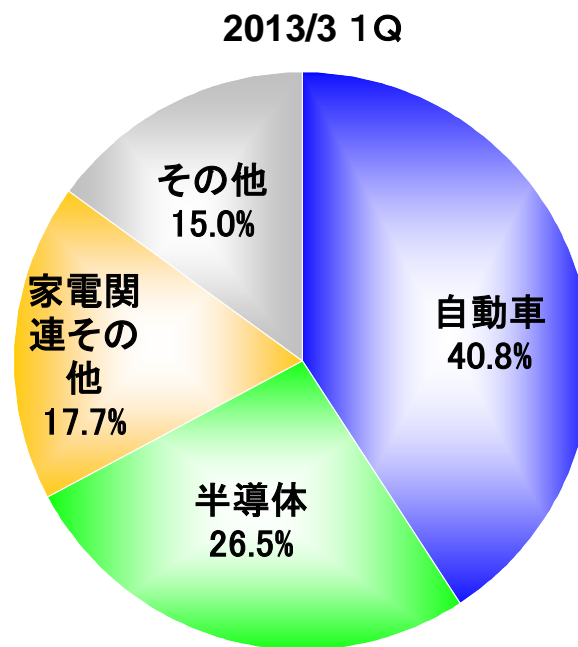
## ■ 引き続き、北米メーカーを中心に自動車関連の受注は続くが、全体的に低調。

- ・ 自動車関連設備：北米メーカー、国内部品メーカー等からの受注が継続。
- ・ 半導体関連設備：国内および北米メーカーからの受注が続くものの、低調な水準。
- ・ 家電関連およびその他：家電、タイヤ等、全体的に低調。

### 事業部門別受注高の状況

単位：百万円

事業部門	2013/3 1Q
自動車	3,249
半導体	2,104
家電関連その他	1,408
その他	1,192
合計	7,954



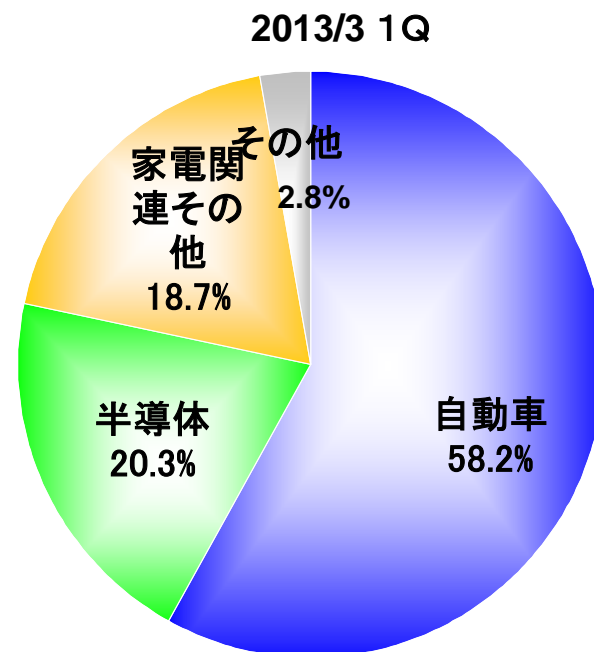
【注】今期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。

- FPD関連の受注減少はあるものの、自動車関連その他、各部門とも堅調な水準を維持。

## 事業部門別受注残高の状況

単位：百万円

事業部門	2012/3 1Q
自動車	11,685
半導体	4,068
家電関連その他	3,765
その他	563
合計	20,082



【注】今期より区分を変更し、FPD関連事業を半導体事業に組み入れたため、前年同期との比較は行っていません。



## **IV 2013年3月期業績の見通し**

---

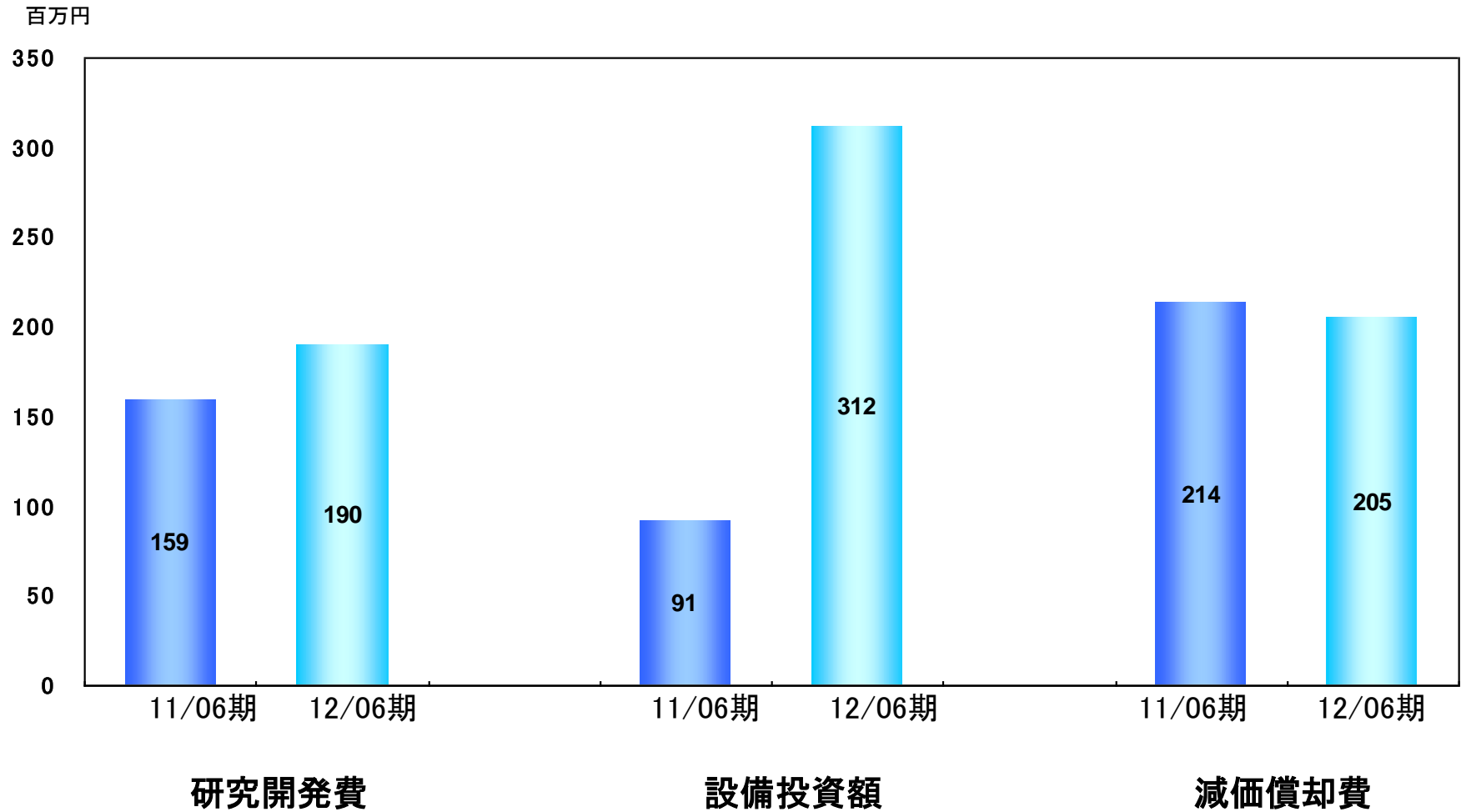
2013年3月期第1 四半期（2012年6月30日）

※業績予想に変更はありません。

(単位:百万円)

	上期	下期	通期
売上高	26,000	23,000	49,000
自動車関連	11,000	7,500	18,500
半導体関連	7,600	8,200	15,800
家電関連およびその他	4,900	4,800	9,700
その他	2,500	2,500	5,000
営業利益(率)	1,000 (3.8%)	500 (2.2%)	1,500 (3.1%)
経常利益(率)	900 (3.5%)	400 (1.7%)	1,300 (2.7%)
当期純利益(率)	600 (2.3%)	200 (0.9%)	800 (1.6%)

【注】FPD関連事業の売上減少により、今期予想からFPD関連事業は半導体関連事業に含めております。

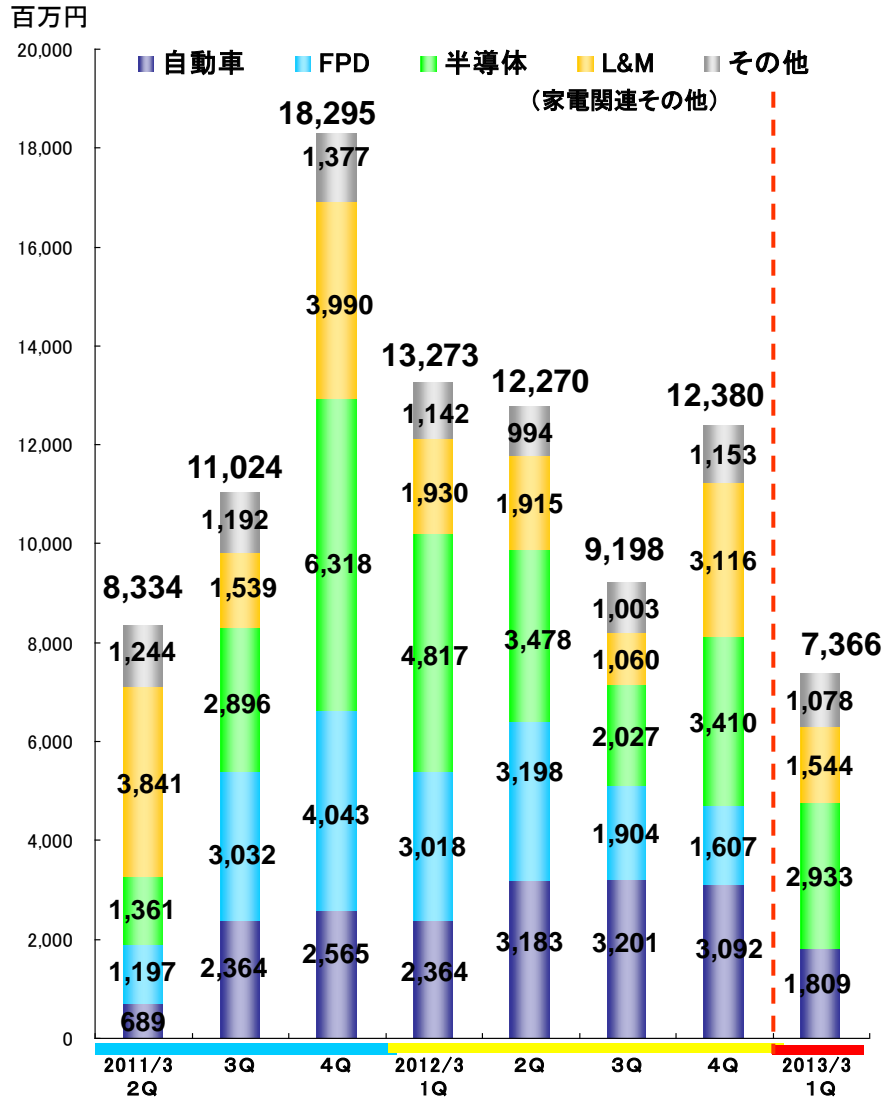


## V 参考資料

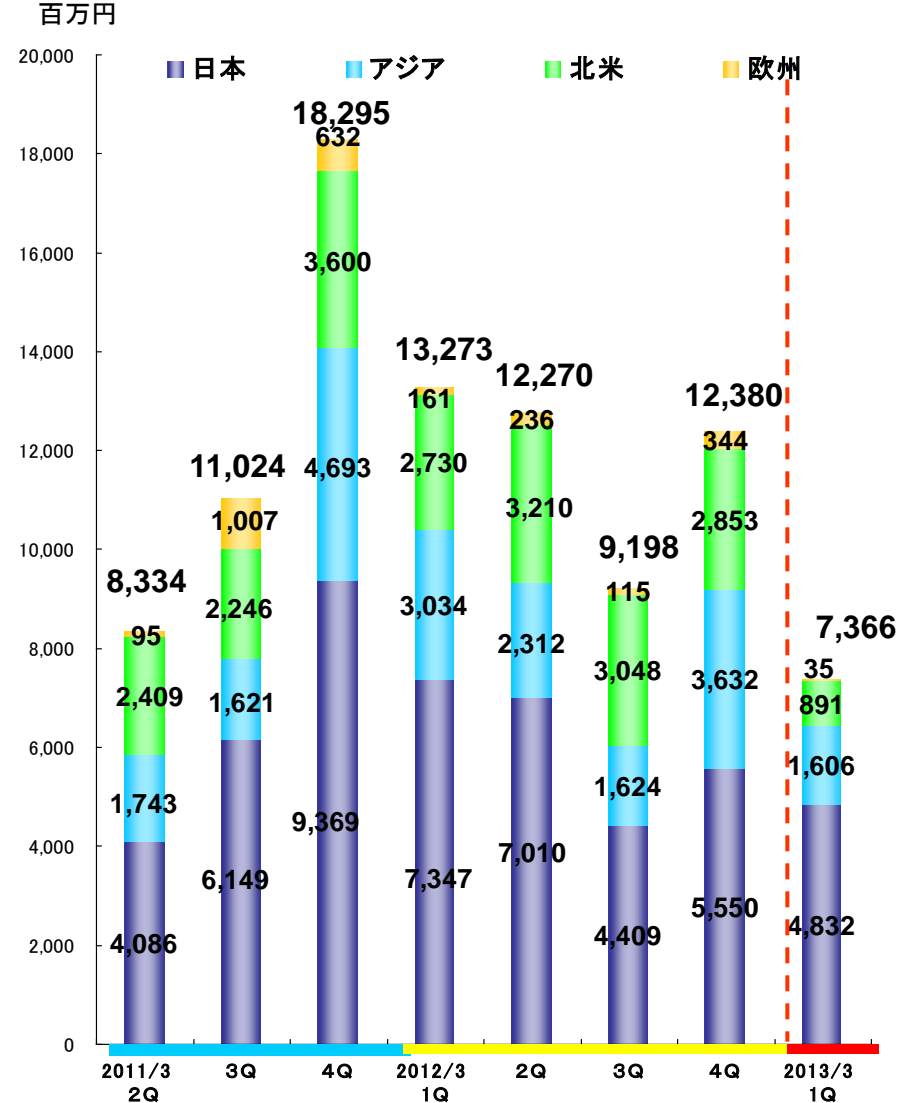
---

2013年3月期第1四半期（2012年6月30日）

### 事業部門別四半期売上高の推移

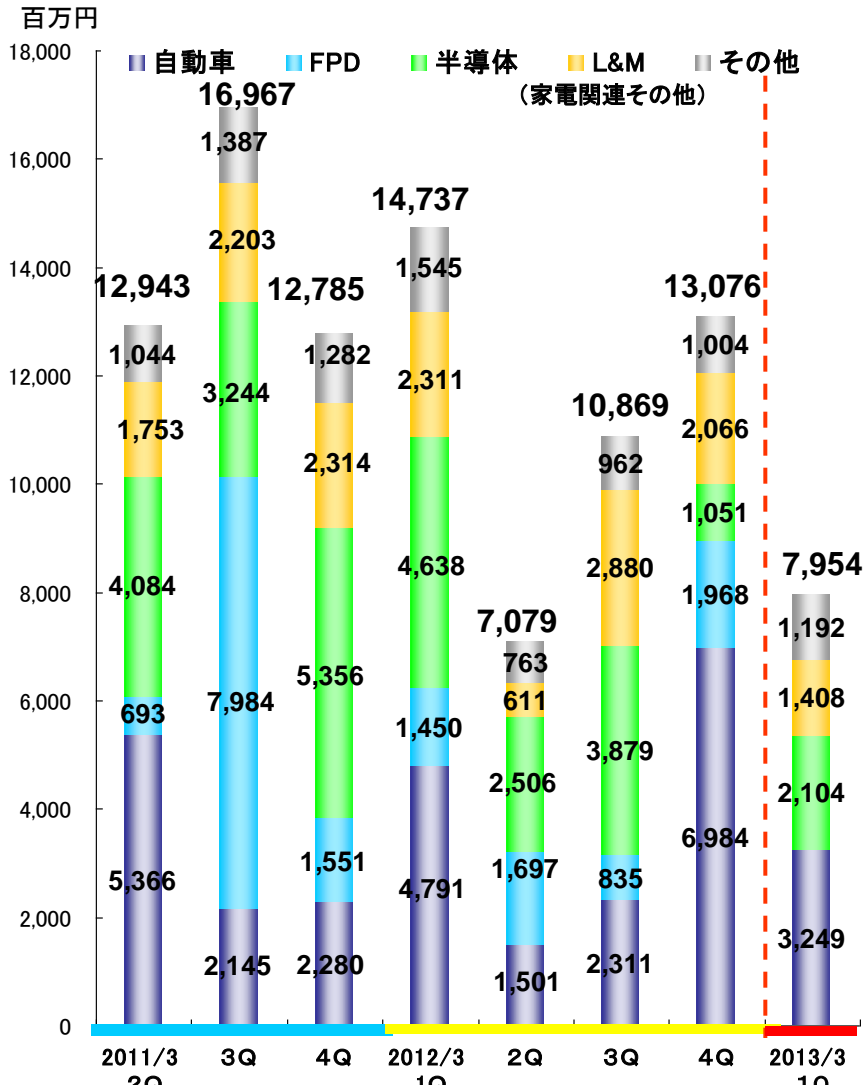


### 地域別四半期売上高の推移

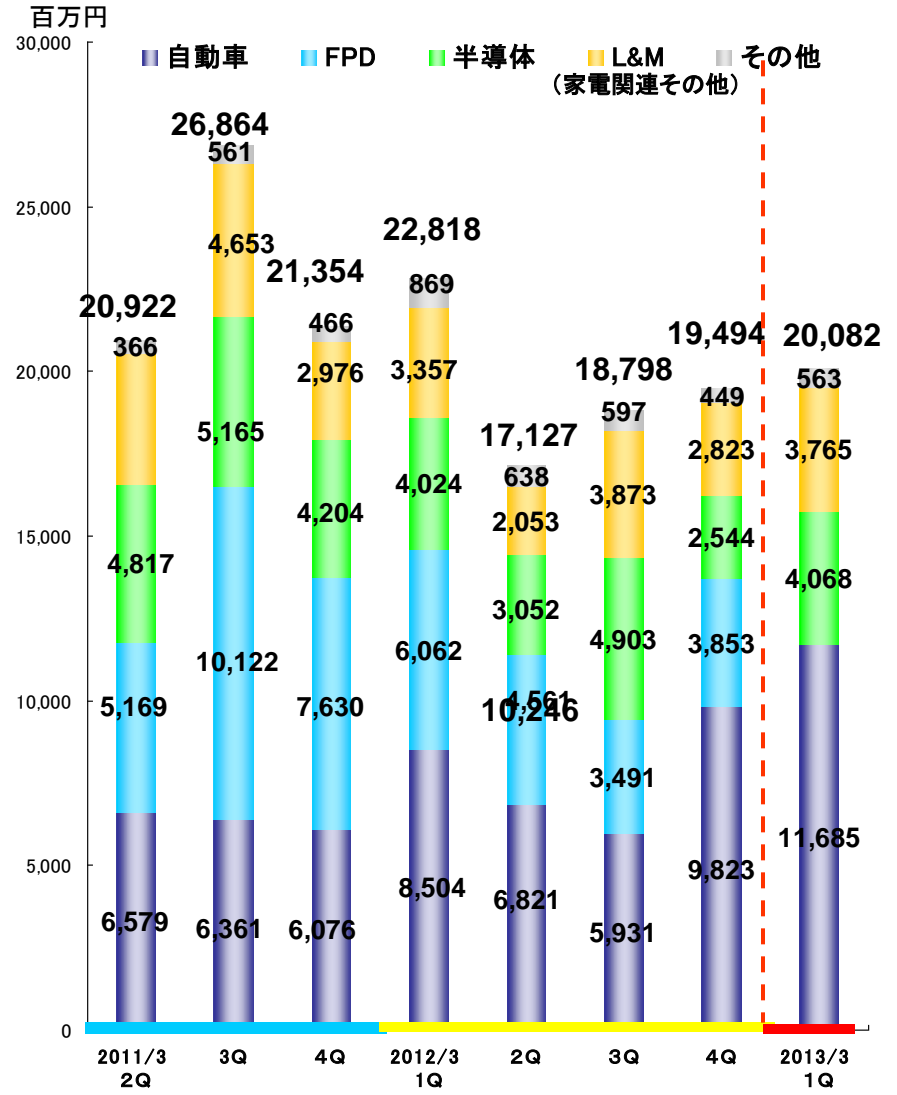


【注】2013年3月期第1四半期より区分を変更し、FPD関連は半導体関連に含めております。また、L&Mは「家電関連その他」に変更しております。

### 事業部門別四半期受注高の推移

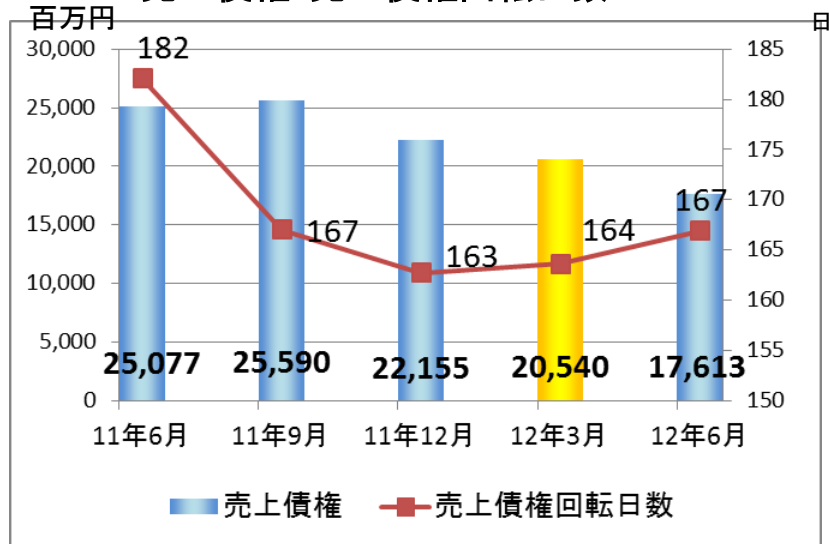


### 事業部門別四半期受注残高の推移

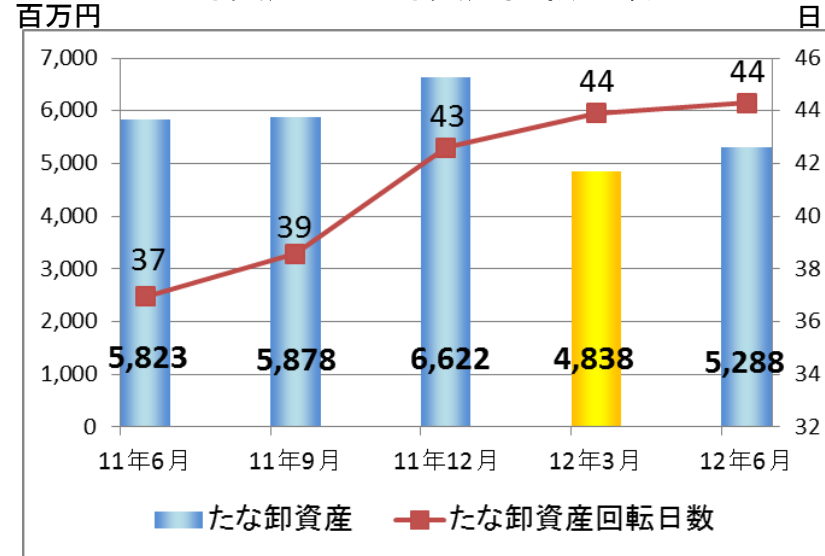


【注】2013年3月期第1四半期より区分を変更し、FPD関連は半導体関連に含めております。また、L&Mは「家電関連その他」に変更しております。

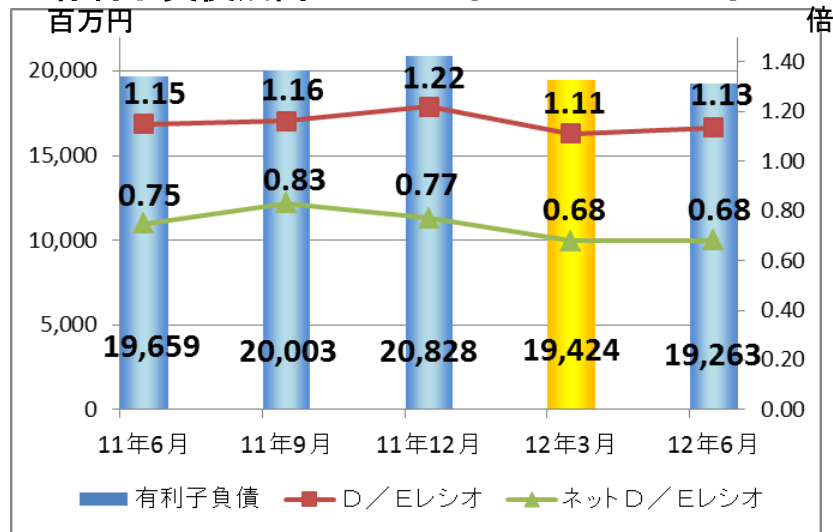
## 売上債権・売上債権回転日数



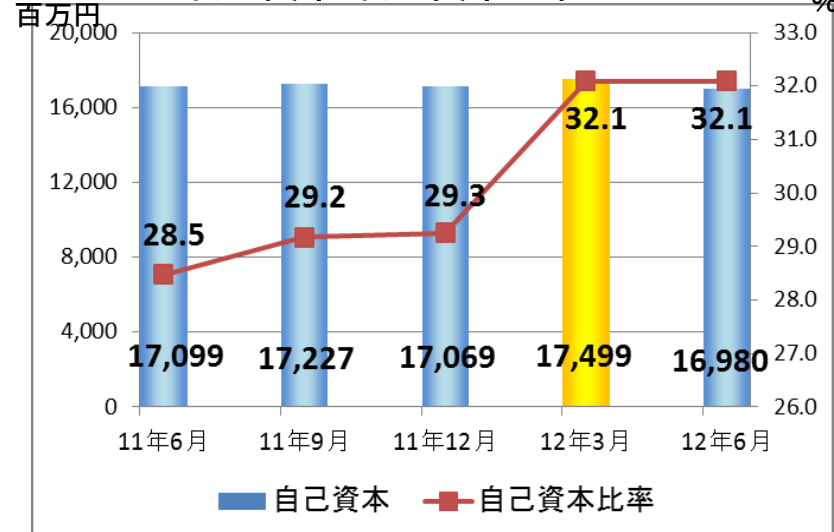
## たな卸資産・たな卸資産回転日数



## 有利子負債残高・D/Eレシオ・Net D/Eレシオ



## 自己資本・自己資本比率



【注】売上債権回転日数、たな卸資産回転日数については、各四半期毎の期中平均値にて算出しております。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承知おきください。